

Product Change Notice (PCN)

件名: Site addition of package assembly and final test

発行日: 7/21/2022

出荷開始予定日: 3/31/2023

改版履歴:

初版

変更内容の説明:

RZ/T1-M, EC-1 製品の安定供給を行うために、組立工場、最終テスト工場を追加、適用いたします。今回追加した組立工場の製品では、パッケージ外形仕様が従来品から一部変更となるため、型名を変更、区別しております。

既存品と追加品の比較については、以下をご参照下さい。

項目	追加品	既存品
会社	組立: Advanced Semiconductor Engineering, Inc FT: King Yuan ELECTRONICS CO., LTD.	(株)アムコー・テクノロジー・ジャパン
場所	組立: Kaohsiung, Taiwan FT: Chu-Nan, Taiwan	組立: 函館工場 FT: 熊本工場
パッケージ組立	変更あり	変更なし
テスター装置	変更なし	変更なし
テストプログラム	変更なし	変更なし

対象製品リスト:

Appendix をご参照下さい。

変更の理由:

RZ/T1, EC-1 の需要対応、安定供給を行うため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

組立工場の変更により、RZ/T1-M はパッケージサイズ Min が 5.80mm から 5.85mm、Max が 6.20mm から 6.15mm に、パッケージの厚さが 1.7mm から 1.35mm に、EC-1 はパッケージサイズ Min が 11.92mm から 11.85mm、Max が 12.03mm から 12.15mm に、パッケージの厚さが 1.6mm から 1.5mm に変更されています。

実装、機能、品質、信頼性は同等であることを確認いたします。

製品の識別方法:

ルネサス型名、パッケージマーキング、梱包ラベルにより識別可能です。

信頼性データについて: お客様のご要求に応じて提供いたします。弊社営業にお問い合わせください。
サンプル出荷予定日: 8/31/2022 (評価用として WS サンプルを提供いたします)

製品/材料の化学物質データ: お客様のご要求に応じて提供いたします。弊社営業にお問い合わせください。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

製品リスト:

R7S910020CBG#AC0	R7S910022CBG#AC0	R9A06G043GBG#AC0	
R7S910021CBG#AC0	R7S910023CBG#AC0		

変更(追加)型名:

R7S910020CBA#BC0	R7S910022CBA#BC0	R9A06G043GBB#BC0	
R7S910021CBA#BC0	R7S910023CBA#BC0		

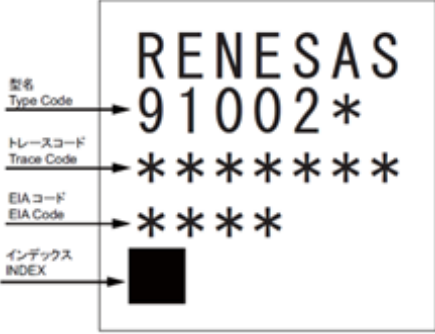
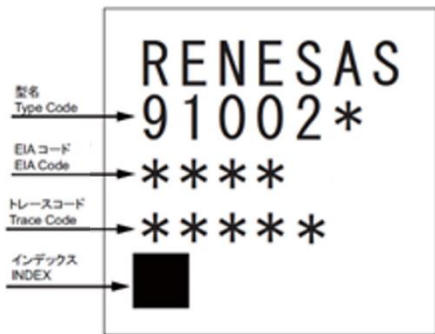
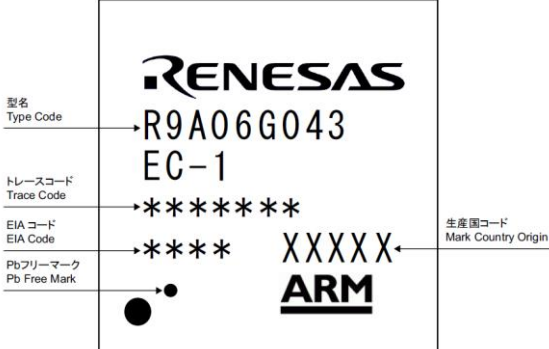
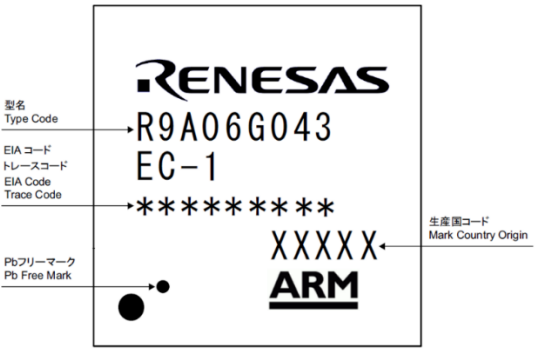
注文単位は RZ/T1-M: 3,920 個、EC-1: 1,344 個 (内装箱 1 個の満杯数量) です。

パッケージ外形:

既存品					追加品				
RZ/T1-M (112BGA)									
	Symbol	Dimension in Millimeters				Symbol	Dimension in Millimeters		
		Min.	Nom.	Max.			Min.	Nom.	Max.
Package size	D	5.80	6.00	6.20	Package size	D	5.85	6.00	6.15
Package size	E	5.80	6.00	6.20	Package size	E	5.85	6.00	6.15
Total thickness	A	-	-	1.70	Total thickness	A	-	-	1.35
Stand off	A1	0.20	0.25	0.30	Stand off	A1	0.20	0.25	0.30
Ball pitch	e	-	0.50	-	Ball pitch	e	-	0.50	-
Ball width	b	0.25	0.30	0.35	Ball width	b	0.25	0.30	0.35
Ball offset (Package)	x1	-	-	0.20	Ball offset (Package)	x1	-	-	0.15
Ball offset (Ball)	x2	-	-	0.05	Ball offset (Ball)	x2	-	-	0.05
Coplanarity	y	-	-	0.08	Coplanarity	y	-	-	0.08
Mold parallelism	y1	-	-	0.20	Mold parallelism	y1	-	-	0.20

既存品					追加品				
EC-1 (196BGA)									
	Symbol	Dimension in Millimeters				Symbol	Dimension in Millimeters		
		Min.	Nom.	Max.			Min.	Nom.	Max.
Package size	D	11.92	12.00	12.08	Package size	D	11.85	12.00	12.15
Package size	E	11.92	12.00	12.08	Package size	E	11.85	12.00	12.15
Total thickness	A	-	-	1.60	Total thickness	A	-	-	1.50
Stand off	A1	0.35	0.40	0.45	Stand off	A1	0.36	0.41	0.46
Ball pitch	e	-	0.80	-	Ball pitch	e	-	0.80	-
Ball width	b	0.45	0.50	0.55	Ball width	b	0.45	0.50	0.55
Ball offset (Package)	x1	-	-	0.15	Ball offset (Package)	x1	-	-	0.15
Ball offset (Ball)	x2	-	-	0.08	Ball offset (Ball)	x2	-	-	0.08
Coplanarity	y	-	-	0.10	Coplanarity	y	-	-	0.10
Mold parallelism	y1	-	-	0.20	Mold parallelism	y1	-	-	0.20

パッケージマーク仕様:

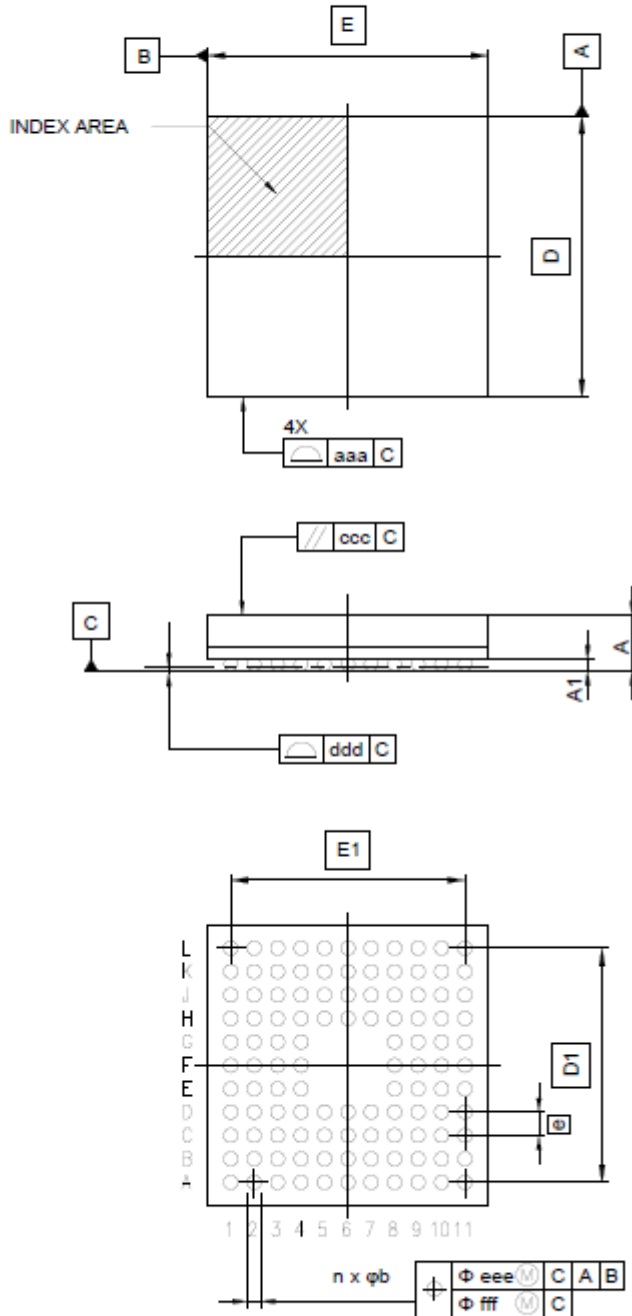
既存品	追加品
<p>RZ/T1-M (112BGA)</p> 	<p>RZ/T1-M (112BGA)</p> 
<p>EC-1 (196BGA)</p> 	<p>EC-1 (196BGA)</p> 

梱包ラベル仕様:

既存品	追加品
<p>RZ/T1-M (112BGA)</p> <p>D/N: R7S91002XCBG ACOWL01000</p> <p>SPN: R7S91002XCBG#AC0 ACOWL01000</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>D/N: R7S91002XCBG ACOWL02000</p> <p>SPN: R7S91002XCBG#AC0 ACOWL02000</p>	<p>RZ/T1-M (112BGA)</p> <p>D/N: R7S91002XCBA U03L</p> <p>SPN: R7S91002XCBA#BC0 BCOM503000</p>
<p>EC-1 (196BGA)</p> <p>D/N: R9A06G043GBG ACOWL01000</p> <p>SPN: R9A06G043GBG#AC0 ACOWL01000</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>D/N: R9A06G043GBG ACOWL02000</p> <p>SPN: R9A06G043GBG #AC0 ACOWL02000</p>	<p>EC-1 (196BGA)</p> <p>D/N: R9A06G043GBB U03L</p> <p>SPN: R9A06G043GBB#BC0 BCOM503000</p>

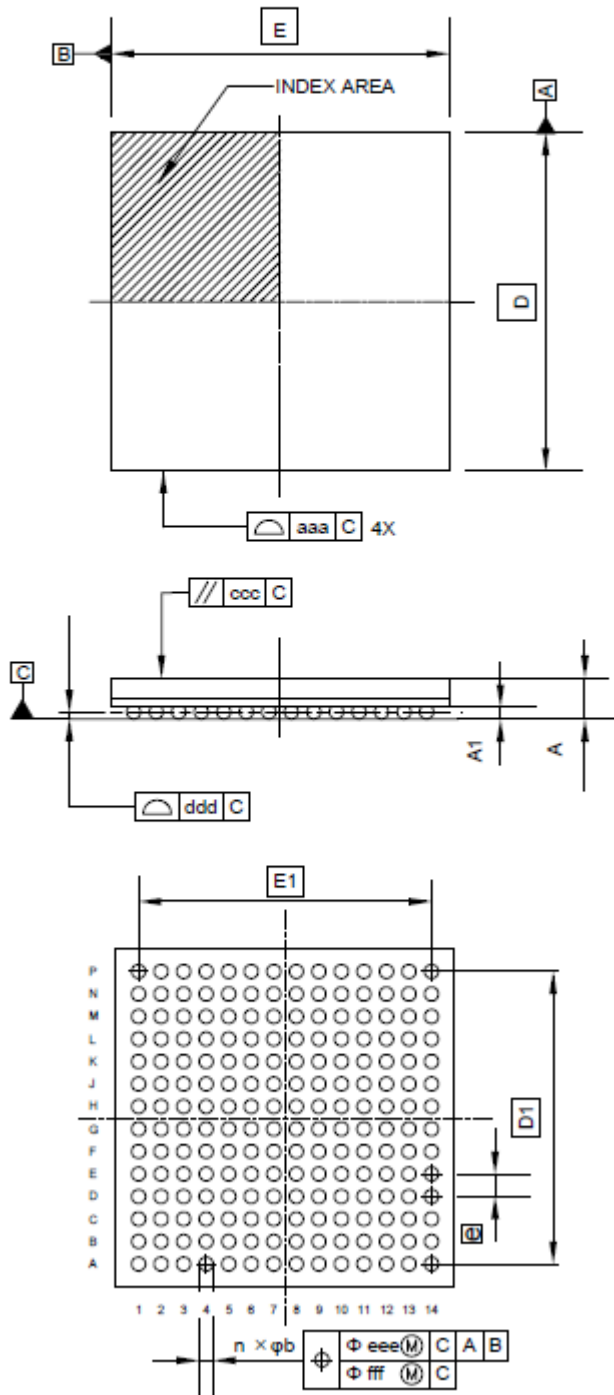
パッケージ外形詳細仕様：
RZ/T1-M (112BGA)

JEITA Package code	RENESAS code	MASS(TYP.)[g]
P-LFBGA112-6x6-0.50	PLBG0112KB-A	0.09



Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min.	Nom.	Max.
D	—	6.00	—
E	—	6.00	—
D1	—	5.00	—
E1	—	5.00	—
A	—	—	1.35
A1	0.20	—	—
b	0.25	0.30	0.35
e	—	0.50	—
aaa	—	—	0.15
ccc	—	—	0.20
ddd	—	—	0.08
eee	—	—	0.15
fff	—	—	0.05
n	—	112	—

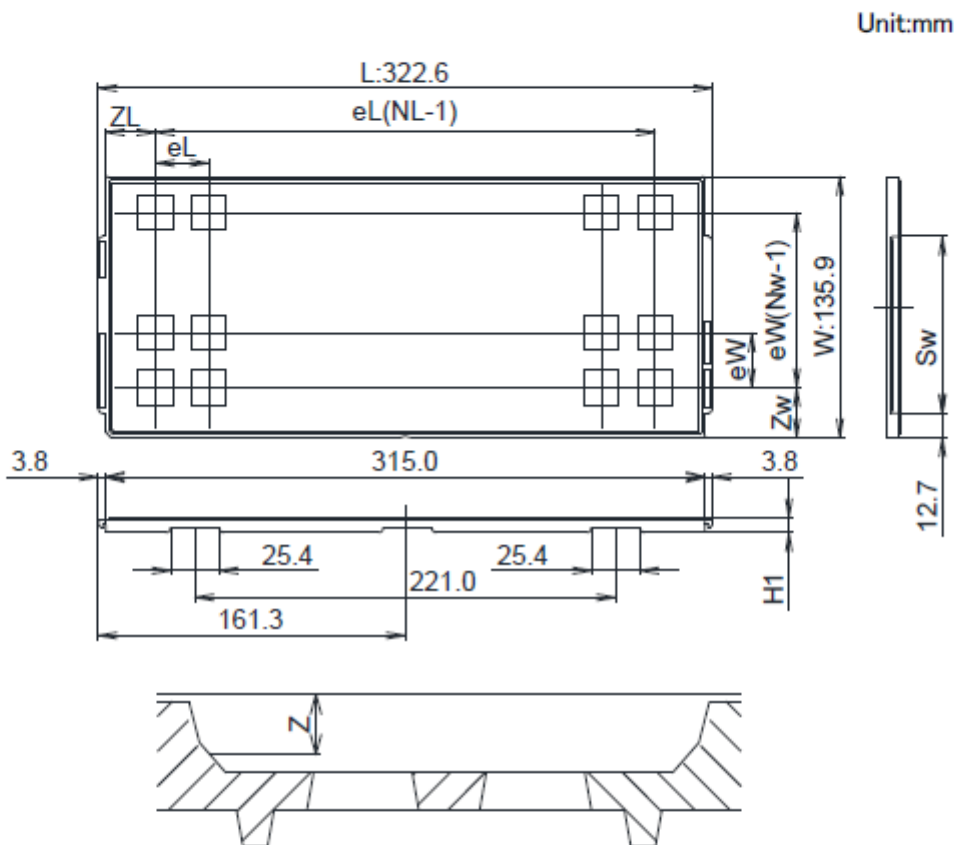
JEITA Package code	RENESAS code	MASS(TYP.)[g]
P-LFBGA196-12x12-0.80	PLBG0196GB-A	0.43



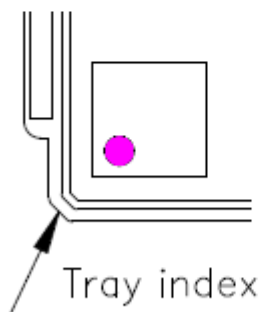
Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min.	Nom.	Max.
D	—	12.00	—
E	—	12.00	—
D1	—	10.40	—
E1	—	10.40	—
A	—	—	1.50
A1	0.36	—	—
b	0.45	0.50	0.55
e	—	0.80	—
aaa	—	—	0.10
ccc	—	—	0.20
ddd	—	—	0.10
eee	—	—	0.15
fff	—	—	0.08
n	—	196	—

包装仕様（トレイ包装図）：
RZ/T1-M（112BGA）

包装仕様 Packing Specification トレイ包装図 Tray Outline Drawing BJ-R105	ルネサスエレクトロニクス株式会社 Renesas Electronics Corporation
--	---



The pin1 is located in the hatching portion.



tray Code		BJ-R105
Position dimension of cells	Z	1.65
	Zw	8.15
	ZL	7.90
	eW	9.20
	eL	8.80
	Sw	92.10
Thickness (mm)	H1	7.62
Number of cells	Nw	14
	NL	35
Maximum storage Pcs. IC/Tray		490
Maximum storage Pcs. IC/Inner box		3920
Material		Carbon PPE
Heat resistant temperature		135°C MAX
JEDEC or Custom		JEDEC
Surface resistance		$1.0 \times 10^4 \leq R < 1.0 \times 10^{11} \Omega$

